

# The Semiconductor Lifecycle Solution™

**La più ampia fornitura continua di semiconduttori a livello globale.**

*Autorizzato al 100% da oltre 70 produttori leader di semiconduttori. Rochester ha oltre 15 miliardi di dispositivi in magazzino che comprendono oltre 200.000 codici. Rochester ha prodotto oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in magazzino, Rochester ha la capacità di produrre oltre 70.000 tipi di dispositivi. Visita il nostro sito web [www.rocelec.it](http://www.rocelec.it).*

## Servizi di assemblaggio

### Assemblaggio ermetico

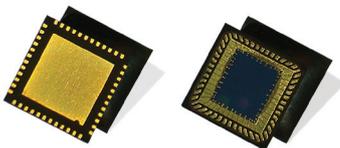
- Apparecchiature di assemblaggio automatiche e semiautomatiche
- Attacco die eutettico, in vetro argentato e in resina epossidica
- Fritta, sigillo di saldatura e sigillatura di Saldatura package metallici
- Riproduzione di package inclusi i leadframe
- Certificazione DLA
- Apparecchiature flessibili per la gestione di combinazioni di diversi tipi di package
- Flussi commerciali e militari
- Test di affidabilità interni
- Sono disponibili servizi di qualificazione

### Open Cavity Package

Offriamo un'ampia gamma di Open Cavity Package (OCP) per la prototipazione IC, che consentono di accelerare il time-to-market per il lancio di nuovi prodotti.

I servizi di assemblaggio includono:

- Lappatura del retro del wafer
- Wafer dicing
- Attacco die
- Incollaggio di filo
- Incapsulamento
- Marcatura laser



### Assemblaggio in plastica

- Apparecchiature automatiche per taglio, attacco die e wire bonding
- Spazio di produzione flessibile a supporto dei piani aziendali, dalla produzione di linee a basso volume/ alto assortimento alla produzione di linee dedicate ad alto volume.
- Gold ball bond
- Attacco die in resina epossidica
- Soluzioni di assemblaggio personalizzate
- Sono disponibili servizi di qualificazione
- Apparecchiatura completa per stampi automatici e semiautomatici
- Spazio di produzione flessibile per la gestione di un'ampia gamma di volumi

### Component Lead Finishing

- Placcatura in SnPb, Sn opaco e Ni
- Il sistema di placcatura con griglia flessibile supporta la placcatura di leadframe e altri componenti elettronici Configurable for other plating solutions
- Configurable per altre soluzioni di placcatura
- Opzioni di saldatura a immersione



### Riproduzione del package, del substrato e del leadframe

- Capacità di reintrodurre la maggior parte delle tecnologie di package
- Sono disponibili finiture ROHS/SnPb
- Package in conformità con le specifiche JEDEC e package personalizzati
- Sono disponibili servizi di progettazione di substrato e leadframe
- Sono disponibili servizi di qualificazione

# The Semiconductor Lifecycle Solution



Oltre 15 miliardi di dispositivi finiti in stock

- Oltre 200.000 codici costruttore in stock
- Oltre 12 miliardi di die in stock
- Oltre 20.000 tipi di dispositivi prodotti
- Capacità di produrre oltre 70.000 tipi di dispositivi
- Prodotto utilizzando le informazioni trasferite direttamente a Rochester dal produttore del componente originario (OCM)

- Produzione continua *or products in stock*
- Prodotti realizzati su ordinazione
- Qualifica in range di temperatura commerciale, industriale e militare, Rochester R, Rochester B, MIL-STD-883C, SMD/QML e Space Level S/V
- Selezioni di standard industriali di packaging e varietà di finiture dei contatti inclusi Sn, SnPb e RoHS



## Sede aziendale centrale

Rochester Electronics, LLC  
16 Malcolm Hoyt Drive  
Newburyport, MA 01950  
United States

Telefono: +1.978.462.9332  
Fax: +1.978.462.9512  
sales@rocelec.com  
www.rocelec.com

## Sede centrale EMEA

Rochester Electronics Ltd.  
Unit 2 Fenice Court  
Eaton Socon, St Neots  
Cambridgeshire PE19 8EW  
United Kingdom

Telefono: +44.1480.408400  
Fax: +44.1480.407669  
emeasales@rocelec.com  
www.rocelec.com

## Sede centrale APAC

Rochester Electronics PTE. LTD.  
21 Bukit Batok Crescent  
#18-75 WCEGA Tower  
Singapore 658065

Telefono: +65.6653.6788  
Fax: +65.6653.6799  
apacsales@rocelec.com  
www.rocelec.com

## Sede in Giappone

Rochester Electronics Ltd.  
Sunshine 60 Bldg, 11F  
3-1-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-Ku  
Tokyo 170-6011  
Japan

Telefono: +81.3.6709.2630  
Fax: +81.3.6709.2631  
japansales@rocelec.com  
www.rocelec.jp

Visita [www.rocelec.it](http://www.rocelec.it) per vedere tutti i nostri uffici vendite regionali.